(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平11-220263

(43)公開日 平成11年(1999)8月10日

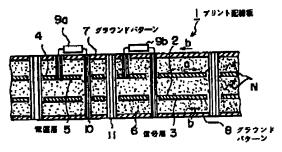
(51) Int.CL*	識別記号	FI
H05K 3/46	1	H05K 3/46 Z
		1/02 N
H01L 23/12		9/00 R
H05K 1/02		H01L 23/12 N
9/00	•	名の 12 20/12 名が 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(21)出頭番号	<b>岭頭平</b> 10-17401	(71) 出版人 000000295 沖電気工業株式会社
(22) 出版日	平成10年(1998) 1月29日	東京都港区元ノ門1丁目7番12号 (72)発明者 森本 倫弘 東京都港区元ノ門1丁目7番12号 沖電気 工業株式会社内
		(72)発明者 小林 順 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気 工業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 大西 健治

## (54) 【発明の名称】 ブリント配線板

### (57)【要約】

【課題】 電磁波ノイズの放射を防止するプリント配線 板を提供する。

【解決手段】 電子部品9a、9bに電源を供給するための電源パターン4を配線した電源層5と電子部品9a、9bの動作により電液が流れる信号パターン2を配線した信号層3を、複数のグラウンド層7、8で挟むように配設し、グラウンド層7、8同土を複数箇所で接続する。



第1の実施の影響のプリント記載領を示す構成所正数

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子部品に電源を供給するための電源パ ターンを配線した電源層と電子部品の動作により電流が 流れる信号パターンを配線した信号層、およびグラウン ドバターンを配線したグラウンド樹とを有するプリント 配線板において、

前記グラウンド層を複数設けて前記電源層および前記信 号層を複数のグラウンド層で挟むように配設し、

グラウンド層同士を複数箇所で接続したことを特徴とす るプリント配線板。

【謝水項2】 プリント配線板の表表の表層がグラウン ド層である請求項1記載のプリント配線板。

【請求項3】 グラウンド暦同士の接続は電子部品によ り行われる諸求項1記載のプリント配線板。

【請求項4】 グラウンド層同士の接続は、プリント配 線板全体に亙って密にした鈴求項1記載のプリント配線

【諸求項 5】 グラウンド層同士は外形の形状が同一で ある諸求項1記載のプリント配線板。

【請求項6】 グラウンド暦同土の接続はブリント配線 板の周縁部に行われる請求項1記載のブリント配線板。

【請求項7】 複数のグラウンド層が挟む前記電源層ま たは前記信号層の周縁部にグラウンド層を設けた請求項 1 記載のプリント配線板。

【請求項8】 電子部品に電源を供給するための電源パ ターンを配線した電源層と電子部品の動作により電流が 流れる信号パターンを配線した信号層、およびグラウン ドパターンを配線したグラウンド層とを有するプリント 配線板において、

前記電源層と前記グラウンド層とで前記信号層を挟むよ うに配設し、前記電源層と前記グラウンド層とをコンデ ンサを介して接続したことを特徴とするプリント配線

【請求項9】 前記電源層と前記グラウンド層のコンデ ンサによる接続は、プリント配線板全体に亘って密にし た踏水項8記載のプリント配線板。

【騎求項10】 前記電源層と前記グラウンド層は外形 の形状が同一である請求項8記載のプリント配線板。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、集積回路(IC) や大規模集積回路(LSI)等の電子部品を搭載するブ リント配線板に関し、とくに電磁波ノイズの低減を図っ たプリント配線板に関する。

#### [0002]

【従来の技術】プリント配線板は、ICやLSI等の電 子部品を搭載し、電子回路を構成するものである。プリ ント配線板には、電子部品への電源供給のために面状の 電源パターンを配線した電源層と面状のグラウンドパタ ーンが配築されたグラウンド層が配設されており、さら に搭載された電子部品同士を接続して電子回路を構成す るための信号パターンが配線される信号層が配設されて いる。電板層、グラウンド層、信号層の各層の間は絶縁 体により電気的に絶縁されている。信号層同士の接続、 また電子部品の電源層およびグラウンド層との接続は、 スルーホールやピアにより行われる。

【0003】電子回路が動作すると、信号層内の信号パ ターンや電影層とグラウンド層の間から電磁波ノイズが 発生する。この電磁波ノイズに対しては、従来、プリン ト配線板全体を金属の筐体で囲んで電磁波ノイズをシー ルドしたり、また電磁波ノイズを抑制するための専用の 部品をあらたにプリント配線板に搭載したりして、その 低減を図っていた。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来 の技術においては、プリント配線板から放射される電磁 波ノイズを金属の筐体でシールドする場合、この金属筐 体が大きいのでプリント配線板を使用する電子機器が大 型化するという問題と、金属筐体があらたなアンテナと なって電磁波ノイズを放射するという問題があり、また 電磁波ノイズを抑制するための専用の対策部品を新たに プリント配線板に搭載する場合には、コストが上昇する という問題があった。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】上記評題を解決するため に本発明は、電子部品に電源を供給するための電源パタ 一ンを配線した電源層と電子部品の動作により電流が流 れる信号パターンを配線した信号層、およびグラウンド パターンを配線したグラウンド層とを有するプリント配 線板において、前記グラウンド層を複数設けて前記電源 層および前記信号層を複数のグラウンド層で挟むように 配設し、グラウンド層同士を複数箇所で接続したことを 特徴とする。

【0006】上記構成の本発明によれば、電子部品が動 作すると、信号パターンや電源層の電源パターンに電流 が流れ、この電流によって電磁波ノイズが発生する。し かし、電源層および信号層をグランド層で挟み込み、グ ランド層同士を複数箇所で接続したことにより、グラン ド層のグランドパターンに電源層の電源パターンや信号 パターンに流れる電流とは逆方向に同じ大きさのリター ン電流が流れる。このリターン電流により電磁波ノイズ が打ち消される。

### [0007]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を図面 を参照しながら詳細に説明する。なお、各図面に共通す る要素には同一の符号を付す。図1は本発明に係る第1 の実施の形態のプリント配線板を示す概略断面図であ る。

【0008】図1において、ブリント配線板1は、信号 パターン2が配線された信号層3と電源パターン4が配

線された電源層5を中層に配設している。信号層3と電 源層 G は絶縁体 B の中に埋設されている。プリント配線 板 1 の表面(上面)および裏面(下面)にはグラウンド パターン7、8が配散されている。グラウンドパターン 7、8はそれぞれグラウンド暦を構成する。表面のグラ ウンドパターン7上には電子部品9a、9bが搭載され ている。電子部品9a、9bは電額が供給される電子部 品で、電源パターン4と表裏のグラウンドパターン?に 接続されている。 電源パターン4には電子部品9 a、9 **bの電源供給側が接続され、グラウンドパターン7には** 電子部品9 u、9 bのグラウンド側が按続されている。

【0009】表側のグラウンドパターン7と裏側のグラ ウンドパターン8はスルーホール10により接続されて いる。スルーホール10とグラウンドバターン7との接 統位置と、スルーホール10とグラウンドパターン8と の接続位置は、プリント配線板1の水平方向に対して線 対称の位置(座標的に同じ位置)になっている。またブ リント配線板1にはスルーホール11が形成され、この スルーホール11により表側のグラウンドパターン7と 裏側のグラウンドパターン8が接続されている。スルー ホール11のグラウンドパターン7、8との接続位置も 絵対称の位置になっている。

【0010】図2はグラウンドパターン7、8を示す祭 祝図である。図2において、表側のグラウンドパターン 7と裏側のグラウンドパターン8は、ともに板状に形成 され、外形が同じ形状になっている。グラウンドパター ン7、8の各所には、両グラウンドパターン7、8を接 続するためのスルーホールまたは電子部品を接続するた めのスルーホール用の穴12が形成されている。

【0011】図1、2において、電源が供給される電子 都品9a、9bのグラウンド側に設けられるスルーホー ル10とスルーホール11は表側のグラウンドパターン 7と裏側のグラウンドパターン8を接続する接続部を形 成するが、この接続部はプリント配線板1の全体に亘っ て密に、例えば約10mm四方の間隔で設けられてい る。この10mm四方の間隔は、厳密に設定しなければ ならないものではなく、概略設定すればよいが、例えば 1 GHzまでの電磁波ノイズを抑えるためには少なくと も20mm四方に1個は接続部を設けるようにする。接 統部としては、プリント配線板1金体に亘って専用のス ルーホールIIを設けなくても、図1に示すような電源 が供給される電子部品9が搭載されていれば、その電子 部品9用のスルーホールを利用して両グラウンドパター ン7、8を接続するようにしてもよいのである。

【0012】次に実施の形態における電磁波ノイズを低 減する動作について説明する。図1において、電子部晶 9aまたは9bが動作すると、信号パターン2および電 源パターン4に電流が流れ、信号パターン2および電源 パターン4から電磁波ノイズNが発生する。このとき、 電源層5が両グラウンドパターン7、8に挟まれるよう

に配設され、かつ両グラウンドパターン7、8が接続部 により完全に接続されているので、信号パターン2およ び電源層5に電流が流れることによってグラウンドパタ ーン7、8に逆方向のリターン電流が流れる。即ち、あ る瞬間において電源パターンAにaで示す方向の電流が 流れたとすると、両グラウンドパターン7、8にはbで 示す方向のリターン電流が流れる。

【0013】グラウンドパターン7、8にリターン電流 が流れると、電磁波ノイズNとは逆方向の電磁波が発生 し、電磁波ノイズNを打ち消す。

【0014】電源層8および信号層3の上下にグラウン ドパターン7、8が設けられておらず、また接続部で接 続されていない場合には、電源層5および信号層3とグ ラウンドパターンとの電気的結合が完全ではないので、 プリント配線板が具備される電子機器の金属低体や大地 等の他の導電体にリターン電流が流れ、信号パターンや 電源パターンに流れる電流とリターン電流との距離が遠 くなる。この結果、電磁被ノイズNを十分に打ち消すこ とができず、プリント配線板から電磁液ノイズNを放射 することになる。

【0015】本実施の形態では、衷裏のグラウンドパタ ーン7、8で信号層3および電源層5を挟み、しかも密 に歌けた接続部により両グラウンドパターン7、8を完 全に接続したので、電子部品9が動作した場合に流れる リターン電流を両グラウンドパターン7、8のみに流れ るようにでき、電磁波ノイズNを打ち消すのに十分な電 **敏波を発生させることができる。また本実施の形態で** は、図2に示すように、両グラウンドパターン7、8の 外形形状を同じにしているので、リターン電流はよく流 れるようになっている。

【0016】なお上記実施の形態では表裏のグラウンド パターン7、8をスルーホール10、11により接続し ているが、他の導電部材で接続するようにしてもよい。 【0017】図3、図4は第1の実施の形態のブリント 配線板1の電磁波ノイズを計測した実験結果を示す説明 図であり、図3は水平偏波を示し、図1は垂直偏波を示 す。また図5、図6は従来のブリント配線板の電磁波ノ イズを計測した実験結果を示す説明図であり、同様に図 5 は水平偏被を示し、図6は垂直偏波を示す。各図にお いて横軸はプリント配線板から放射される電磁波の周波 数(単位はMHz)を示し、縦軸はブリント配線板から 放射される電磁波ノイズの強度(単位は  $d \, B \, \mu \, V$ )を示 す。これらの図から分かるように、実験結果から見ても 実施の形態のプリント配線板1では従来のプリント配線 板に較べて放射される電磁波ノイズが大幅に抑制されて いる。

【0018】上述した実施の形態では4層のプリント配 線板を例にして説明したが、本発明は3層以上の多層プ リント配線板であれば適用可能である。図7は6層のプ リント配線板に適用した例を示し、図8は8層のプリン

ト記線板に適用した例を示す。図7、図8に示す例はと もに上記実施の形態のものと同様に、友層と裏層にグラ ウンドパターン7、8を配設したもので、両グラウンド パターン7、8により中層の信号パターン2および電源 **贈5を挟み、両グラウンドパターン7、8は多数箇所で** 互いにスルーホール10およびスルーホール11で接続 されている。この例では上述の実施の形態に較べて信号 **圏3の数が多くなっており、中層の暦構成が異なるが、** 電磁波ノイズの抑制の効果は変わらない。

【0019】図9乃至図12に示す変形例は、2つのグ ラウンドパターンの少なくとも一方が中層になっている 例である。これらの各変形例において、グラウンドパタ ーン7、8の両方またはいずれか一方が中層として配設 ·されている。岡グラウンドパターン7、8の間には、電 額暦5だけか、または電源層5と電磁波ノイズの発生に 関係する信号層3とともに配設されている。グラウンド パターン7または8の外側には電磁波ノイズを気にする 必要のない信号暦14が配設されている。これらの変形 例において、両グラウンドパターン7、8は密に接続さ れていることに変わりはない。このような変形例におい ても電磁波ノイズの抑制の効果が得られる。

【0020】図13は本発明の第2の実施の形態のプリ ント配線板の信号層を示す平面図、図14は第2の実施 の形態の電源層を示す平面図である。図13、図14に おいて、第2の実施の形態のプリント配線板において は、信号パターン21が配線された信号層22の周囲に 環状のグラウンドパターン23が配設されている。また 電源層24の周囲にも環状のグラウンドパターン25が 配設されている。ここでは図示していないが、この実施 の形盤においても前記実施の形態と同様に、複数のグラ ウンド層により信号層22と電源層24を挟むように機 成されており、信号層22と電源層24を挟むグラウン ド層の外形はグラウンドパターン23の外形と同一の形 状をしている。

【0021】環状のグラウンドパターン23、25には ほぼ均等の間隔でスルーホール用の穴26が全面に置っ て形成されており、この穴26を使用して環状のグラウ ンドパターン23、25は、伝号層22と電線層24を 挟むグラウンドパターンと接続する。

【0022】信号パターン21がブリント配線板の端部 に配線されている場合、信号パターン21はプリント配 線板のグラウンドパターン以外にも電気的に結合しやす くなり、信号パターン21に対するリターン電流はプリ ント配線板のグラウンドパターン以外にも流れやすくな るので、電磁波ノイズが若干放射される。第2の実施の 形態では、環状のグラウンドパターン23、25を信号 層22および電源層24の周囲に設けたので、始部の信 号パターン21からの電磁波ノイズの放射を防止するこ とができる。

【0023】とくに本実施の形態では、信号暦22と電

顕暦24を上下から挟むだけではなく、信号パターン2 1もしくは電源パターンと同一平面上にグラウンドパタ ーンを設けたことにより、信号パターン21または電源 パターンを遮蔽箱(シールドボックス)に入れたのと同 じ状態になり、電磁波ノイズの放射をより一層防止する ことができる。

【0024】第2の実施に形態においても、プリント配 線板の周囲だけではなく、その内側の部分でも信号暦2 2と電源層24を挟むグラウンドパターンが互いに密に 接続されているものとする。なお第2の実施の形態の変 形例として、異状のグラウンドパターンを設けることな く、信号層22と電源層24を挟むグラウンドパターン 同士の接続部を環状に設けることでも第1の実施の形態 よりも電磁波ノイズの放射を防止する効果が上がること はいうまでもない。

【0025】上記第1、第2の実施の形態では、複数の グラウンド層を設けて電源層と信号層を挟んでいるが、 電源層とグラウンド層で信号層を挟み、電源層とグラウ ンド層間をコンデンサを介して接続しても電磁被ノイズ の放射を防止する効果がある。 このような構成の第3の 実施の形態を図15に示す。

【0026】図15において、第3の実施の形態のプリ ント配線板30においては、電源暦31とグラウンド層 32とで信号層33を挟む構成になっており、電源層3 1 とグラウンド関 3 2 はコンデンサ 3 4 およびスルーホ ール35を介して接続されている。コンデンサ34は前 記実施の形態と同様にプリント記線板30全体に亘って 万温無く密に配置されるが、例えば1GHzまでの電磁 波ノイズを抑えるためには20mm四方に1個程度の割 合でコンデンサ34を設けて電源暦31とグラウンド層 32を接続するようにする。なお電源暦31とグラウン ド層32との接続は、できるだけ座標的に同じ位置で行 うようにし、電源層31の外形形状とグラウンド層32 の外形形状はほぼ同一になっている。

【0027】この第3の実施の形態においても、3層以 上のプリント配線板に対して実施可能であり、電磁波ノ イズを抑制したり信号層を電源層とグラウンド層とで挟 むようにし、電源層とグラウンド層とをコンデンサを介 して接続することにより、電磁波ノイズの放射を防止す ることができる。

#### [0028]

【発明の効果】以上詳測に説明したように、木発明は、 グラウンド層を複数設けて電源層および信号層をこれら の複数のグラウンド層で挟むように配設し、グラウンド 層同士を複数箇所で接続したことにより、電磁波ノイズ の放射を防止することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態のブリント配線板を 示す機略断面図である。

【図2】グラウンドパターンを示す斜視図である。

【図3】第1の実施の形態の電磁被ノイズの側定結果を 示す図である。

【図4】第1の実施の形態の電磁波ノイズの測定結果を 示す図である。

【図5】従来の電磁被ノイズの測定結果を示す図であ ٥,

【図6】従来の電磁波ノイズの測定結果を示す図であ ٥.

【図7】6層のプリント配線板に適用した例を示す図で

【図8】8層のプリント配線板に適用した例を示す図で ある。

【図9】変形例を示す機略断面関である。

【図10】変形例を示す概略断面図である。

【図11】変形例を示す機略新国図である。

【図12】変形例を示す機略断面図である。

【図13】第2の実施の形態の信号層を示す平面図であ

【図14】第2の実施の形態の電源層を示す平面図であ

【図15】第3の実施の形態のプリント配線板を示す概 略断面図である。

【符号の説明】

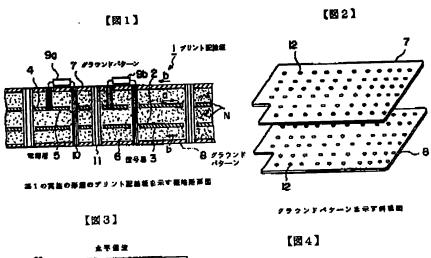
1 プリント配線板

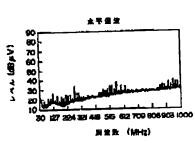
3 佰号層

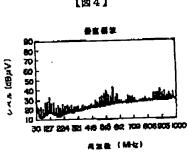
5 電源層

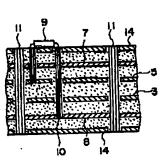
7、8 グラウンドパターン

9 a 、9 b 電子部品









医骨骨毛炎小板皮肤直包

[图9]

[图6] 三年 二年 80 80 70 (A#BD) 441 30 127 224 321 418 515 612 709 806 905 1000

の地質法ノイズの別定指導を水平国

